

### 2-2-2-5 気泡介在 SR 不付き / SR 存在気泡的剥落 / Solder resist missing by bubble

【特徴】 S R が円形状に不付きになっている状態の欠陥

【特徴】 SR が円形剥落状態の缺陷。

【Characteristics】 Solder resist does not coat in the form of a disk.

【原因・判断ポイント・発生工程】カーテンコータでの S R 塗布工程で、S R インク中に介在した気泡により、S R が塗布されずに出来たもの（カーテンコータ工程）

【原因、判断要点、发生工序】在落帘 SR 涂布工序，SR 油墨吸附气泡，妨碍 SR 涂布而引起的（落帘涂布工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】 Solder resist does not coat a board because of a bubble in the resist ink in the solder resist application using the curtain coater to cause the defect. (Curtain coater process)



【コメント】顕微鏡倍率 ×

【注釋】显微镜倍率 ×

【Comments】Magnification: ×



【コメント】顕微鏡倍率 ×

【注釋】显微镜倍率 ×

【Comments】Magnification: ×

### 2-2-2-6 SR 膨れ / SR 分层 / Blistered solder resist

【特徴】 S R と板面間が部分的に剥離し膨れている状態の欠陥。

【特徴】 在 SR 和板面之间有局部剥离并分层的缺陷。

【Characteristics】 Solder resist is partially separated from the surface of a board and blistered.

【原因・判断ポイント・発生工程】板面に付着していた水分や薬液、オイル分などが S R と基板との密着力を弱め、その水や薬液などがその後の熱ストレスにより気化した為できたもの（S R 塗布～乾燥工程）

【原因、判断要点、发生工序】板面存在的水分、药液、油等减弱了 SR 与板的结合力，事后在热应力的作用下这些水分、药液等汽化所引起的（SR 涂布～干燥工序）。

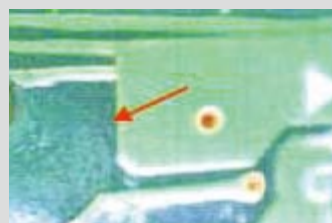
【Causes/processes involved/keys to judgment】Moistures, chemicals, oils, etc. left on the board surface weaken/reduce the adhesion between the solder resist and the board, and vaporize by subsequent heating, causing the defect. (Solder resist coating - curing)



【コメント】顕微鏡倍率 ×

【注釋】显微镜倍率 ×

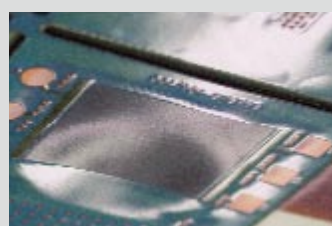
【Comments】Magnification: ×



【コメント】顕微鏡倍率 ×

【注釋】显微镜倍率 ×

【Comments】Magnification: ×



【コメント】顕微鏡倍率 ×

【注釋】显微镜倍率 ×

【Comments】Magnification: ×